

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-67

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	永赢基金、长信基金、鹏华基金、东方红、五地投资、兴银基金、华富基金、华泰柏瑞、合远投资、国君资管、国泰基金、招银理财、星石投资、泉果基金、泰信基金、西部利得、鑫元基金、泓澄投资、财通资管、理成资产、中泰证券
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2024年11月7日
地点	中泰证券策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2024 年第三季度营业收入及综合毛利率环比变化情况。</p> <p>2024 年第三季度，公司营业收入 47.28 亿元，环比增长 8.45%，主要由于电子装联业务项目结算增加影响，营收规模环比增加。公司综合毛利率环比略有下降，一方面由于电子装联业务规模增长（因业务形态特点，其毛利率一般略低于公司综合毛利率）；同时封装基板及 PCB 业务受产品结构变化影响，业务毛利率环比下降。此外，广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。</p> <p>Q2、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2024 年第三季度，受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响，公司 PCB 业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升，通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响，营收占比有所下降。</p>

Q3、请介绍公司 2024 年前三季度 PCB 业务在数据中心领域经营拓展情况。

数据中心是公司 PCB 业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024 年前三季度，全球主要云服务厂商资本开支重点用于算力投资，带动 AI 服务器相关需求增长，叠加通用服务器 EGS 平台迭代升级，服务器总体需求回温。公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于 AI 加速卡、EGS 平台产品持续放量等产品需求提升。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。

Q4、介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及技术优势。

与传统汽车电子产品相比，公司所聚焦的新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。例如 ADAS 领域相关产品对车载通信及数据处理能力要求更高，涉及高频材料、HDI 工艺、小型化等复杂设计。伴随汽车电动化/智能化趋势的延续及未来车联网等终端应用的涌现，汽车也可能演变为新型的移动数据终端，公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。

Q5、请介绍公司 PCB 业务有无进一步扩产的空间。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q6、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。

Q7、请介绍公司 2024 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应

	<p>用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2024 年第三季度，封装基板下游市场需求有所放缓，公司封装基板产品结构随下游市场需求波动有所调整。</p> <p>Q8、请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。</p> <p>公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有回落。</p> <p>Q9、请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。</p> <p>Q10、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。</p> <p>公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作有序推进中。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。</p> <p>Q11、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。</p> <p>公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>